

2-1-2-35 SR 表面指紋残り／SR 表面印有指紋／Fingerprint on the solder resist surface

【特徴】SR 表面に指紋が付いている状態の欠陥

【特征】在 SR 表面印有指紋的缺陷。

【Characteristics】A fingerprint is printed on solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布後の乾燥前に誤って指で触った為に出来たもの（SR 塗布後乾燥前工程）

【原因、判断要点、发生工序】错误地用手指触摸 SR 涂布后烘干前的板面而引起的（SR 烘干前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by careless contact of a finger with a wet solder resist surface (After solder resist coating and before curing process)



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】指紋ではなく手の紋の場合もある
顕微鏡倍率 ×

【注釋】不仅有指纹, 甚至有掌纹
显微镜倍率 ×

【Comments】Print of palm instead of fingerprint
Magnification: ×

2-1-2-36 SR 過焼き／SR 的烘干过度／Overcured solder resist

【特徴】SR の色合いが変色し、やや茶褐色状態になっている欠陥

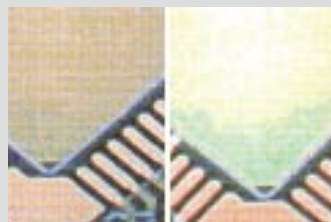
【特征】SR 变色，稍微茶色状的缺陷。

【Characteristics】Solder resist is discoloured and turned a little dark brownish.

【原因・判断ポイント・発生工程】不注意による SR 乾燥時間の設定ミスや、乾燥炉からの取り出し遅れ、あるいは乾燥温度の設定ミスやドリフトなどによりできたもの（SR 乾燥工程）

【原因、判断要点、发生工序】因为疏忽，SR 烘干时间的设定错误、从烘干炉取出不及时，或者烘干温度的设定错误、偏差等所引起的（SR 干燥工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by a careless mistake in cure such as time setting, delay in taking-out of cured panel from curing oven, in cure temperature setting, or cure temperature drift, etc. (Solder resist curing process)



【コメント】左不合格品 右良品
顕微鏡倍率 × 20

【注釋】左是不合格品，
右是合格品
显微镜倍率 × 20

【Comments】Left: Rejected
Right: Good
Magnification: ×20



【コメント】左不合格品 右良品
顕微鏡倍率 × 20

【注釋】左是不合格品，
右是合格品
显微镜倍率 ×

【Comments】Left: Rejected
Right: Good
Magnification: ×